[JSPE-59-03] 93-03-448

448

# ファインセラミックスの砥粒加工における 切りくず生成エネルギー\* 彰\*\* 忠

杉田

Chip Formation Energy in Grinding, Honing and Superfinishing of Ceramics

上田

隆

司\*\*

# Takashi UEDA and Tadaaki SUGITA

The chip formation energy, which is consumed only to make chips by brittle fracture in grinding, honing and superfinishing, is investigated theoretically and experimentally. The following model is assumed that the surface of the work material consists of grains in shape of a cube and the brittle fracture takes place at the grain boundary. Work materials used in experiments are Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC and Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> which are sintered under atmospheric pressure, and SiO<sub>2</sub>. The scratching test is also carried out in order to obtain the chip formation energy of ceramic materials, and the strong relation is observed between the chip formation energy and the energy release rate of the ceramic. The chip formation energy obtained from experiments are compared with that from the scratching test.

Key words : chip formation energy, energy release rate, ceramic grinding, ceramic honing, ceramic superfinishing, scratching test

#### 1. 緒 言

著者らはこれまでホーニング、超仕上などの精密加 工法をとりあげ、セラミックスを能率よく加工するた めの砥石の選定,加工条件の設定などについて詳細に 検討を加えてきた<sup>1)~3)</sup>.また,研削・ホーニング・超仕 上におけるセラミックスの被削性についても統一的に 評価する方法について検討してきた4. それによれ ば、効率的な材料除去はぜい性破壊の集積によって行 われるが、砥粒切れ刃の切込みが小さいなど加工条件 が過酷でない場合は、塑性変形型の切りくずを生成す ることになり、良好な加工表面は得られるが、除去さ れる切りくずの量は極端に減少してしまう. そして, 一般の加工はこの両者の混合した状態で行われ、同じ 加工材料でも加工法によってこの比率が異なるためそ の被削性に大きな差を生じることになる.

これらの切りくず除去形態の変化は、砥粒をモデル 化した1個の球状圧子でセラミックス表面を引っかい た場合や、球状圧子をセラミックスに押し込んだ場合 の材料の挙動を調べることにより定性的に検討されて きている. すなわち、変形が塑性内にとどまるか、ま たはき裂が発生して進展するかで評価することができ

る5). ところが、実際の加工現象を扱う場合、セラミッ クスは一般に結晶粒子の焼結集合体で結晶粒界におい て性質が大きく異なっていること、種々の形状をした 多数の砥粒が加工に関与すること、などからこのよう な単純化したモデルでは不十分であり、別の見方に立 つ新たなモデルで検討する必要がある.

そこで本研究では、まず加工材料を結晶粒の集合体 にモデル化して考え、その結晶粒が砥粒の切削作用に よって確率的に粒界で破壊して切りくずを生成してゆ くと考えることにより、比加工エネルギー & の中か ら切りくずを生成するために要する比切りくず生成エ ネルギー ksch を求めることにした.次に、引っかき 試験により材料固有の物性値と考えられる切りくず生 成エネルギーを求め、先の ksch の値の妥当性につい て検討するとともに、ksの中でkschの占める割合に ついても調べてみた. さらに、ダイヤモンド工具とセ ラミックスの間の摩擦係数についても検討した.

#### 切りくず生成エネルギー 2.

一般に、砥粒が切りくずを除去するのに必要な加工 エネルギーを u とすると、逃げ面での摩擦で消費さ れる摩擦エネルギー us,およびそれ以外の切削に消 費されるエネルギー ucを用いて,

$$u = u_{\rm c} + u_{\rm s} \tag{1}$$

原稿受付 平成4年4月27日

<sup>\*\*</sup> 正 会 員 金沢大学工学部(金沢市小立野 2-40-20)

(2)

$$u_{\rm c} = u_{\rm ch} + u_{\rm pl}$$

と表すことができる. セラミックス加工の場合, 切り くずの大半はぜい性破壊によって生じると考えられる ことから, uch はぜい性破壊に必要なエネルギーと し, 塑性変形型の切りくず生成で消費されるエネル ギーは upl に含めることにすると, 式 (1), (2) より

$$u = u_{\rm ch} + u_{\rm pl} + u_{\rm s} \tag{3}$$

と表すことができるが、取扱いをさらに簡単にするため、切りくず生成に寄与しないエネルギー $u_{\text{Pl}}$ を $u_{\text{s}}$ に含めて考えることにする.すると、uを生成された切りくず体積で除することにより、単位体積の切りくずを除去するために必要なエネルギーを表す比加工エネルギー $k_{\text{s}}$ が求まり

 $k_s = k_{sch} + k_{ss}$  (4) となる. ここで,  $k_{sch}$  は単位体積の切りくずを生成す るために必要なエネルギーを表す比切りくず生成エネ ルギーであり,  $k_s$ を比摩擦エネルギーと呼ぶことに する.

すなわち, セラミックスを破壊して単位体積の切り くずを生成するために必要な真のエネルギーは比加工 エネルギー $k_s$ のうちの $k_{sch}$ であり, ここでは $k_s$ から  $k_{sch}$ を分ける方法を考えてみる.

## 2.1 切りくず除去の確率的取扱い

切りくず除去過程を一種の確率的破壊現象とみなし て、加工材料が切りくずとして除去される確率を求め ることにする.ここでは、ホーニング加工の場合を扱 うことにし、他の2つの加工法に対しては得られた結 果を適用することにする.

いま, n本の砥石の内1本の砥石が円筒面を加工している場合を考え,円筒面を軸方向に展開して砥石が加工する様子を示すものが図1である.

解析に先立ち次のような仮定を置くことにする.

- (1) 加工材料の加工表面は図1に示すように矩形 状の粒子が集積して形成されているものとし,こ れらの粒子間の境界を粒界とみなす.
- (2) 切りくずは粒界での破壊で生じるとし、体積 の少ない塑性変形型の切りくずは無視する.
- (3) 粒子は粒界で支持されており、砥粒切れ刃に よって仕事(エネルギー)を受けたとき粒界で確 率的に破壊して切りくずとなる.

図1において、微小時間 Δ*T* に砥石がはく加工物 表面積は

### $l_{ m e} V \Delta T$



Fig. 1 Model of workpiece surface in honing

ただし,

$$l_{\rm e} = \frac{1}{B - l + 2a} \{ l(B - l + 2a) - a^2 \} \cos \theta$$

その面積中にある1辺 dg の粒子の個数 ng は

$$n_{\rm g} = \frac{l_{\rm e} \, V \Delta \, T}{d_{\rm g}^2} \tag{5}$$

このとき,砥石の切削抵抗を F<sub>t</sub> とすると,砥石のな す仕事は

$$F_t V \Delta T$$
したがって,1個の粒子に加えられる仕事 g' は $E d^2$ 

 $g' = \frac{F_{\rm t} d_{\rm g}}{l_{\rm e}}$ 

ここで、砥石作業面における切れ刃砥粒数、および加 工表面の凹凸を考慮し、真に砥石切れ刃と接している 粒子の割合を γ で表すと\*、切れ刃に接して仕事を受 けている粒子数は γng となる.したがって、実際に1 個の粒子が受けている仕事 g は

$$g = \frac{F_{\rm t} dg^2}{\gamma l_{\rm e}} \tag{6}$$

となる.

- 81 -

一方, 仕事 g が加えられたとき, 1 個の粒子が粒界 で破壊する確率がワイブル確率関数

$$F(g) = 1 - \exp\{-(g/g_0)^m\}$$
(7)

で与えられたとすると、砥石が時間 △*T* の間加工することによって粒界で破壊される粒子数は

<sup>\*</sup> 結晶粒が切りくずとして除去された跡など実際の加工表面 には凹凸があるが、切りくず生成機構を考えるうえでは砥 石作業面の切れ刃の分布状態との相対関係のみが重要であ る.そこで、このモデルでは加工表面は常に結晶粒が一様 に配列しているものとし、凹凸の影響はγに含ませて考え ることにする.

Table 1 Characteristics of ceramics

	$\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$	SiC	Si₃N₄	SiO2
Density g/cm <sup>3</sup>	3.70	3.12	3.26	2.21
Hardness HV	1 580	2 520	1 870	700
Bending strength MPa	343	441	735	60
Fracture toughness $K_{IC}$ MN/m <sup>3/2</sup>	3.86	4.81	6.02	0.7
Elastic modulus E GPa	370	430	284	80
Poisson's ratio $\nu$	0.21	0.15	0.26	0.17
Modulus of resilience* MOR $J/m^3$	$150 \times 10^{3}$	$226 \times 10^{3}$	$951 \times 10^{3}$	$23 \times 10^3$
Energy release rate $G_c = J/m^2$	38.5	52.6	119	5.95

\* Bending strength is used.

が得られる.

式(8),(9)より,

ただし,

$$\overline{d} = \frac{\pi D B (B - l + 2a)}{n V \{ l (B - l + 2a) - a^2 \} \cos \theta} \frac{\mathrm{d}(\delta R)}{\mathrm{d}\tau}$$

(8)

(9)

(10)

砥石と加工物との接触面積の割合  $\gamma$ ,および粒子の大 きさ  $d_g$  を仮定することにより,式(6)で与えられる gをワイブル確率紙の横軸,式(10)で与えられる  $F(g) を縦軸にプロットすることにより <math>m \ge g_0$ を決 定することができ,粒子が除去される確率を表す確率 関数が求まる.

2.2 切りくず生成エネルギー,摩擦係数

切れ刃より粒子に仕事gを加えたとき,式(7)で 表される割合の粒子が破壊して切りくずとなる.すな わち,破壊した粒子に加えられた仕事は切りくず生成 に寄与し,他の仕事は切りくず生成に寄与できなかっ たとの見方もできる.したがって,全消費エネルギー Uは切りくず生成に寄与したエネルギー  $U_c$ と寄与で きなかったエネルギー  $U_s$ に分けることができ,

 $U \!= U_{\rm c} \!+ U_{\rm s}$ 

$$= UF(g) + U\{1 - F(g)\}$$
(11)

と表すことができる.このエネルギーを切削量で除すると、単位体積の切りくずを生成するために必要な比切りくず生成エネルギー $k_{\rm sch}$ 、および単位体積の切りくずを生成する際に消費される比摩擦エネルギー $k_{\rm ss}$ を求めることができ、

$$k_{\rm sch} = k_{\rm s} F(g) \tag{12}$$
$$k_{\rm ss} = k_{\rm s} \{1 - F(g)\} \tag{13}$$

$$\kappa_{\rm ss} - \kappa_{\rm s} (1 - \Gamma(g))$$

で表される\*.

ここで,砥石に作用する砥石押付け力を *F*<sub>n</sub>,砥石 と加工物の間の摩擦係数を *µ* とすると,近似的に

$$U_{\rm s} = F_{\rm n} \mu V \Delta T$$

一方,

Table 2 Experimental conditions

Grinding speed V m/min	1 530
Work speed v m/min	10
Feed f mm/rev	5
Over-run $a \ (=b/3)$ mm	8
Depth of cut $t = \mu m$	2.5-20
Honing speed V m/min	30
Crosshatch angle $2\theta$ deg	20
Stroke S mm	70
Over-run a mm	10
Finishing speed V m/min	40
Frequency $N$ cpm	900
Amplitude <i>a</i> mm	1.6

$$U_{\rm s} = \Delta D k_{\rm s}$$

より,

$$\mu = \frac{l_e \bar{d}}{F_n} k_s \{1 - F(g)\}$$
(14)

となり、摩擦係数 μを求めることができる.

超仕上に対しても *le*=*l* と置くことによりホーニン グの結果をそのまま適用することができる.一方,研 削加工に対しては同様の考え方を適用することにより

$$g = \frac{F_t dg^2}{\gamma b} \frac{V + v}{v} \tag{15}$$

$$F(g) = \frac{t}{\gamma d_{g}} \tag{16}$$

$$\mu = \frac{b\,\overline{t}\,v}{F_{\mathsf{n}}(V+v)}k_{\mathsf{s}}\{1-F(g)\}\tag{17}$$

となる. ただし、v: 加工物回転速度、V: 砥石回転 速度、b: 砥石幅、 $\overline{t}$ : 静止砥石切込み深さで

$$\overline{t} = \frac{\pi B D t}{b(B - b/3)} \frac{f}{v}$$

### 2.3 実験結果への適用

表1に示すセラミックスを表2の加工条件のもとで 加工した.砥石の特性値,および加工物の形状を表 3,4に示す.得られた実験結果に対して式(6),(10), (15),(16)を用いてgおよびF(g)を求め,ワイブル

まり.

F

 $\gamma n_{\rm g} F(g)$ 

体積になおすと、切削量 $\Delta D$ が求

一方,砥石切込み深さを ā とする

 $\Delta D = \gamma n_{\rm g} F(g) d_{\rm g}^{3}$ 

 $\Delta D = l_e V \Delta T \overline{d}$ 

 $F(g) = \frac{\overline{d}}{\gamma d_g}$ 

<sup>\*</sup> F(g)が大きくなって破壊確率が大きくなればそれだけ大きな割合のエネルギーが切りくず生成に使われ、摩擦エネルギーの割合が減少することになる。このことは図5において、 d が大きくなると & が小さくなることからも明らかである。

451

	Grinding wheel	Honing stick	Superfinishing
Bond	Resin	Metal	Metal
Grain type	CSGII	MBG-660	Micron powder
Grain size	#60/80	# 140/170	#1000
Concentration	80	50, 100	100
Diameter $d \mod mm$	256		
Length / mm		50	20
Width b mm	24	3	3

Table 3 Characteristics of wheel, sticks and stones

Table 4	Size	of	wor	kpiece
---------	------	----	-----	--------

	Grinding	Honing	Superfinishing
Diameter D mm	41-46	41-46	45
Length (Width) B mm	100	100	20

確率紙にプロットした結果が図2である\*. いずれの 材料に対しても、またいずれの加工法に対しても実験 結果は直線に載っており、切りくず生成過程を式(7) の形で表すことができることがわかる. これらの結果 より傾き m、および go を求めた結果をまとめたもの が表5である. 一般に、mの値は研削で大きく、 ホーニング、超仕上と小さくなっている. また、図2 (b)のホーニング加工の場合、アルミナで破壊確率 F(g)が大きく、窒化けい素、炭化けい素の順に小さ くなっており、炭化けい素では加工エネルギーの大部 分が摩擦に消費されていることがわかる. 一方、図2 (a)の研削は多量の仕事を加工表面に加えることに よって加工能率を向上させているといえる.

これら破壊確率を用いて式 (12) より比切りくず生 成エネルギー $k_{sch}$ , および式 (14), (17) より摩擦係数  $\mu$ を求めた結果が表6である.同じ材料でも加工法に より多少の差はあるが,オーダ的には近い値といえ る.これらの値の妥当性は、次の節の引っかき試験で 求まる切りくず生成エネルギーと比較することによっ て検討することにする.

## 3. 引っかきによる切りくず生成エネルギー

切りくず生成エネルギー ksch は一種の材料固有の 物性値とも考えられる.そこで,砥粒切れ刃による切 りくず生成状態に近い状態での ksch を求めるため, 引っかき試験を行った.これにより,ダイヤモンド工



**Fig. 2** Weibull distribution function of *g* 

Table 5 Values of Weibull's parameter

		Grinding	Honing	Superfinishing
т	$Al_2O_3$	1.85	1.55	1.05
	SiC	1.70	2.05	1.35
	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	2.70	1.85	1.15
g <sub>0</sub> J	$Al_2O_3$	$4.71 \times 10^{-7}$	$3.7 \times 10^{-7}$	29.4×10 <sup>-7</sup>
	SiC	$10.9 \times 10^{-7}$	$43.1 \times 10^{-7}$	$24.6 \times 10^{-7}$
	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	$29.3 \times 10^{-7}$	$9.93 \times 10^{-7}$	$42.5  imes 10^{-7}$

具との間の摩擦係数も同時に求めることができる.

#### 3.1 実験方法

セラミックスは加工実験に供した材料と同一ロット で常圧焼結した  $Al_2O_3$ , SiC,  $Si_3N_4$  および SiO<sub>2</sub> を用 いている(表 1).実験装置,実験条件は文献 1)と同

*d<sub>g</sub>*, γの値について:切りくずの大きさの測定結果や結晶粒の大きさなどから<sup>1)</sup>,いずれの材料に対しても *d<sub>g</sub>*=5 μm とした.経験に基づき,集中度 50 の砥石でホーニングしたSiC,Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>の場合を γ=0.05 とし,集中度 100 の砥石を用いた Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> で γ=0.1,超仕上では γ=0.07,研削では加工物回転速度に対して砥石回転速度が非常に大きいため γ=1とした.

#### 精密工学会誌 59/3/1993

**Table 6** Values of  $k_{\rm sch}$  and  $\mu$ 

	Commis	Machining			Court al.
Ceramic		Grinding	Honing	Superfinishing	Scratching
	$Al_2O_3$	4.58	1.52	3.96	1.89
k <sub>sch</sub> J∕mm³	SiC	6.96	3.48	4.64	2.81
	Si₃N₄	24.5	2.85	2.36	5.85
	SiO2		_	_	0.60
μ	$Al_2O_3$	0.02	0.10	0.27	0.33
	SiC	0.08	0.12	0.35	0.33
	Si₃N₄	0.05	0.06	0.16	0.27
	SiO <sub>2</sub>	199000		—	0.25

様であり、一定荷重を加えた円すい形ダイヤモンド工 具(ロックウェル硬度計用圧子、先端角120°、ノー ズ半径 200  $\mu$ m)で、引っかいたときの引っかき抵抗 接線分力  $f_n$  垂直分力  $f_n$ を測定した.引っかき速度 は 1 mm/s である.

#### 3.2 k<sub>sch</sub>, μの導出

距離 $L_s$ 引っかいたとき消費されるエネルギーをuとすると、

 $u = f_t L_s$ 

で表される.このとき,引っかきによって除去された 切りくずの体積は,引っかき痕の平均断面積をAと するとALsと表されることから,比加工エネルギー に相当する比引っかきエネルギー & は

$$k_{\rm s} = \frac{u}{AL_{\rm s}} = \frac{f_{\rm t}}{A}$$

で求めることができる.

一方,引っかきも一種の加工と考えると, u に関して2節と同様の考え方を適用するこ とができる.そこで,uchを引っかきにおけ る切りくず生成エネルギーとし,このとき握 り起こしや塑性変形のために費やされるエネ ルギーを摩擦に費やされるエネルギーに含め てusと表すと

$$u = u_{ch} + u_s$$
 (18)  
と表すことができる.

ここで、摩擦抵抗が押付け力 fn に比例す ると仮定すると

$$u_{\rm s} = \mu f_{\rm n} L_{\rm s} \tag{19}$$

と表すことができる. ただし、 $\mu$ は摩擦係数. した がって、単位体積の切りくずを生成するために必要な 比切りくず生成エネルギー  $k_{sch}$ は

$$k_{\rm sch} = \frac{u_{\rm ch}}{AL_{\rm s}} = \frac{u - u_{\rm s}}{AL_{\rm s}} = \frac{f_{\rm t} - \mu f_{\rm n}}{A} \tag{20}$$

で表されることになる.

一方,摩擦係数 μ は

$$\mu = \lim_{A \to 0} \frac{f_{\rm t}}{f_{\rm n}} = \frac{f_{\rm t0}}{f_{\rm n0}} \tag{21}$$

で求めることができる.

3.3 測定結果

図3(a)は引っかき抵抗 $f_{h}$ , $f_{h}$ を引っかき断面積Aで整理した結果である. 図において,断面積Aを零 に近づけたときの引っかき抵抗 $f_{h0}$ , $f_{n0}$ を求め,式 (21)から $\mu$ を求めた. その結果を表6に示す.



Fig. 3 Scratching test of ceramics with conical diamond



Fig. 4 Relation between  $k_{\rm sch}$  of scratching test and  $G_{\rm c}$ 

求めた $\mu$ ,及び図3(a)の結果を式(20)に代入して $k_{sch}$ を求めた結果が図3(b)である。図より、Aが変化しても丸印で表す計算値はほぼ一定値となっており、この平均値を実線で表し、比切りくず生成エネルギー $k_{sch}$ とし表6に示す。

#### 4. 検 討

#### 4.1 k<sub>sch</sub>の比較

表6において,引っかきにより求めた比切りくず生 成エネルギー $k_{sch}$ と材料のエネルギー解放率 $G_c$ との 関係を調べた結果が図4である.両者の間には線形関 係が成り立ち, $G_c$ の大きな材料ほど $k_{sch}$ が大きくな ることがわかる.また,この関係を使えば $G_c$ から  $k_{sch}$ の値を推定することも可能と考えられる.

加工における  $k_{sch}$  の値は、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>の研削の場合を除き、引っかきに近い値が求まっている。加工状態によって  $k_s$  の値は大きく変化するにもかかわらず引っかきの  $k_{sch}$  に近い値が導出できており、2節での確率的取扱いが妥当であったと考えることができる。

摩擦係数 μは引っかきの場合,材料間に大きな差 はなく,0.3 に近い値となっている.これに対し,加 工では全体に引っかきより小さくなっている.

#### 4.2 **k**s の中で **k**sch の占める割合

図5は一例としてホーニングにおける比加工エネル ギー  $k_s$  および引っかきにおける比引っかきエネル ギー  $k_s$  な d および A で整理し\*,比切りくず生成エ ネルギー  $k_{sch}$  と比較した結果である.引っかきの結 果は切りくず除去の状態で区別しており、  $\triangle$  はぜい 性破壊により大量の切りくずが除去された場合を、 は摩擦が主体となり塑性変形型の少量の切りくずしか 除去されなかった場合を表している.図5(a)の Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の場合,引っかきの  $\triangle$  よりも低いエネルギー

図5の横座標において、*d*とAの間に関連はなく、引っ かきの ksとホーニング加工の ks の値を比較しやすいよう に整理している。



Fig. 5 Comparison of  $k_s$  which are obtained from scratching test and honing

で切りくずが除去されており、ぜい性破壊型の切りく ず領域で効率的な加工が行われていることがわかる.  $\overline{d}$ が大きくなると、 $k_{sch}$ の値に近づいていき、摩擦 に使われるエネルギーがさらに小さくなってゆく.

図5(b)のSiCになると、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>とは逆に、引っか きの  $\triangle$  よりもはるかに大きなエネルギーを消費して 加工が行われている.また、 $k_{sch}$ の値も極めて小さ く、エネルギーの99%程度が摩擦に消費されている.  $k_{sch}$ の値だけでは加工における材料の被削性の判定が むずかしいといえる.

図 5 (c) の Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> では Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と SiC の中間の状態に あるが、それでも  $\blacktriangle$  よりも大きなエネルギーを消費 している. また、 $\overline{d}$  が大きくなっても  $k_{sch}$  の 6~7倍 程度のエネルギーが消費されており、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> の加工で も摩擦に多量のエネルギーが使われている.

図 5 (d) の SiO<sub>2</sub> は Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と同様  $\blacktriangle$  とほぼ同程度の エネルギーで加工されており, 被削性の良いことがわ かる.  $\overline{d}$  が大きくなると  $k_{sch}$  に近い値に収束してお り, 摩擦の占める割合が極めて小さくなっている.

#### 5. 結 言

アルミナ,炭化けい素,窒化けい素といった構造用 セラミックスの加工表面を結晶粒の集合体にモデル化 して切りくず除去過程を確率的に取り扱うことによ り,研削・ホーニング・超仕上で加工する場合に切り くずを生成するために必要なエネルギーを求めた.ま た,引っかき試験により切りくず生成エネルギーを求 め,先の結果と比較検討した.得られた結果をまとめ ると次のようになる.

- 各セラミックスの比切りくず生成エネルギー はSiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>の順で大きくなり, エネルギー解放率と線形関係にある.
- (2) 研削・ホーニング・超仕上における比切りくず

生成エネルギーは引っかき試験による値とオーダ 的に近い値となり,確率的取扱いが妥当であった と考えることができる.

- (3) 引っかきによるダイヤモンド工具とセラミックスの間の摩擦係数はいずれの材料でもほぼ0.3 に近い値となり、加工における摩擦係数はこれよりも小さくなっている。
- (4) ホーニングの場合,被削性のよいSiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> では比加工エネルギー  $k_s$ のうち比切りくず生成 エネルギー  $k_{sch}$ の占める割合が大きいが,被削 性の悪いSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, SiC では  $k_{sch}$ の占める割合が小 さく,特にSiC では  $k_s$ の99% 程度が摩擦で消費 されている.

終わりに,本研究に協力していただいた大阪大学基礎工学部・花見真司氏,三菱電機(株)・裏匡史氏,および実験材料の提供を受けた(株)ミズホ,日本特殊陶業(株),日本グリース(株)に謝意を表します.

#### 参考文献

- 上田隆司,金曽久佳,杉田忠彰:超仕上の加工機構に関 する研究,日本機械学会論文集C編,57,538(1991) 2154.
- 3) 上田隆司,金曽久佳,松森 昇,杉田忠彰:ファインセ ラミックスの超仕上加工―加工条件と被削性,精密工 学会誌、57,7 (1991) 1229.
- 4) 上田隆司,杉田忠彰:ファインセラミックスの研削・ホー ニング・超仕上における被削性の統一的評価,精密工学会 誌, 59,4 (1993)予定.
- 5) 田中芳雄: セラミックスの機械的性質と被加工性, ニューセラミックス, 5 (1988) 37.
- S. Malkin and N. H. Cook : The Wear of Grinding Wheels, Part 1 - Attritious Wear, ASME, J. Eng. Ind., 11, (1971) 1120.